证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号:2025-095

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于珠海金湾基地扩产投资计划的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景旺电子”）于 2025 年 8 月 23 日披露了《景旺电子关于珠海金湾基地扩产投资计划的公告》（公告编号：2025-094），现就上述公告涉及的投资事项补充说明如下：

一、本次扩产投资概况

1、项目投资规模：预计总投资人民币 50 亿元。经初步测算，本次扩产投资项目税后投资回收期约为 7.5 年（含建设期）。

2、项目建设周期：2025 年至 2027 年，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，具体如下。

建设内容	投资金额	预计形成产能	建设周期
在高多层工厂针对性的技术改造补齐瓶颈工序产能、在 HDI 工厂新增 AI 服务器高阶 HDI 产线	10 亿元	利用现有厂房空间，加大设备投入，突破现有产线瓶颈，提升技术能力	2025 年下半年实施完成并投入使用
投资新建高阶 HDI 工厂	32 亿元	年产 80 万 m ² 高阶 HDI 产能	计划于 2025 年下半年开工建设，2026 年中投产
利用储备用地增加投资强化关键工序产能	8 亿元	解决关键技术难题，提升技术能力	计划于 2027 年初建设，2027 年内投产
合计	50 亿元		2025 年至 2027 年（最终以项目实际建设期为准）

3、对公司经营业绩的影响：本次扩产投资项目不会对公司 2025 年度经营业绩产生重大影响，长期经营业绩存在不确定性。

二、本次扩产投资的背景、必要性及可行性

（一）本次扩产投资的背景和必要性

2023 年以来，以大模型与生成式 AI 为代表的技术突破推动科技硬件创新蓬勃发展，高端 PCB 供不应求，市场前景可观。Prismark 预测，在 AI 服务器和高速网络基础设施建设的驱动下，2024-2029 年 18 层以上多层板、HDI 的 5 年复合增长率分别达到 15.7%、6.4%，高于其他应用领域的增长。与此同时，前述应用领域的高端 PCB 技术要求高，产品的附加值也更高，而普通产品则出现竞争加剧的现象。

通过“景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程--年产 120 万平方米多层印刷电路板项目”、“景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程--年产 60 万平方米高密度互连印刷电路板项目”的实施，珠海金湾基地已具备应用于手机、消费电子、汽车、通信、通用服务器等领域所需板厚较薄、尺寸较小的 HDI（含 SLP）、HLC 产能。但是，原有产能难以满足应用于 AI 算力、高速网络通讯、汽车智驾及 AI 端侧应用等高增长领域客户的超高厚径比、超高层数产品提速放量需求。因此，公司必须根据行业的不断变化和市场需求对现有产能进行针对性的技术改造补齐瓶颈工序产能、投资新建高阶 HDI 工厂、利用储备用地增加投资强化关键工序产能，推动公司产品结构升级，提升 AI 算力、高速网络通讯等高端 PCB 的产品占比和市场占有率。

（二）本次扩产投资的可行性

公司是具备 30 余年 PCB 制造专业经验和技術沉淀的国家高新技术企业，在产品技术更新和产业化转化方面的实力雄厚，能为项目的顺利推进提供长期、坚实的技术保障。公司珠海金湾基地在高端 PCB 制造方面已积累了深厚的技术储备和客户基础，其相关方案/产品性能获得了客户的认可，且从中长期市场发展趋势看，相关产品市场需求稳定且具有持续性，为本次扩产项目提供可靠、稳固的市场需求基础。

本次扩产投资项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势，满足新兴领域对高端 PCB 的中长期、高标准需求，具有良好的市场发展前景；扩充公司高阶 HDI、SLP、HLC 产品产能，完善专业化生产线，符合公司持续提升技术创新能力和高端产品占比、聚焦 AI+ 打造第二增长曲线的战略规划要求，保持并拉大领先优势，提高公司经济效益，拓展公司经营规模。

综上，为了抢抓 AI 浪潮下全球科技产业供应链重构之机遇，增强核心竞争力，公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于珠海金湾基地扩产投资计划的议案》，同意使用自有资金或自筹资金人民币 50 亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资，以满足 AI 算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI 端侧应用等领域全球客户的中长期、高标准需求，提升公司在高端产品的市场竞争优势。

三、本次投资风险提示

1、宏观环境、市场需求不及预期及行业竞争加剧，导致产品价格下降、产能利用率不足的风险

本次扩产主要聚焦 AI 算力、高速网络通讯、汽车智驾及 AI 端侧应用等高增长领域。尽管公司对上述市场前景持乐观态度，但相关市场需求受宏观经济周期波动、行业竞争格局变化等多重因素影响，存在不确定性风险。若未来市场需求增长不及预期，同类产品的行业竞争加剧，可能导致产品价格下降、产能利用率不足，影响本次扩产项目的投资回报周期。公司将持续密切跟踪市场动态和技术趋势，加强与核心客户的战略合作与需求预判，灵活调整生产计划和产品结构，并通过强化成本控制和技术创新来提升产品竞争力以应对市场变化。

2、项目建设及产能释放不及预期，导致建设周期延长、实际投资额超出预算的风险

本次扩产项目投资金额较大、建设周期较长，在实施过程中，可能存在工程建设进度不及预期、设备采购及安装调试延期、原材料价格大幅波动等问题，导致项目建设周期延长、实际投资额超出预算，实际产能爬坡速度和达产时间与预期存在差异。公司将组建专业的项目管理团队，制定详细的项目实施计划和应急预案，加强与供应商及承建商等合作伙伴的沟通协调，严格控制项目进度和成本管理，确保项目按计划推进。

3、技术迭代与产品研发面临良率不稳定、生产效率不高等风险

高端产品技术含量高，对生产工艺、设备精度及研发能力要求极高。若公司在技术研发、工艺创新方面未能持续投入或未能准确把握行业技术发展趋势，可能导致新增产能的技术水平未能跟上市场需求变化，产品竞争力下降。新产品在

量产过程中可能面临良率不稳定、生产效率不高等问题，影响项目盈利能力。公司将持续加大研发投入，保持与国内外先进设备及材料供应商的合作，密切关注行业前沿技术动态，加强与下游核心客户的联合开发，确保技术和产品的领先性，同时强化内部生产工艺的优化和管理，提升新产品良率和生产效率。

4、若未来经营活动现金流不及预期，面临一定的资金风险

本次扩产计划总投资 50 亿元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金。若未来公司经营活动现金流不及预期或外部融资环境发生不利变化，可能面临一定的资金筹措压力。截至 2025 年 3 月 31 日，公司营业收入 33.43 亿元，货币资金 27.30 亿元，总资产 203.41 亿元，资产负债率 41.62%，最近三个年度经营活动产生的现金流量净额复合增长率为 21.34%。公司资信情况良好，银行授信额度充足，没有对公司经营产生重大影响的对外担保。公司将根据项目建设进度和资金需求，与合作厂商充分协商更友好的付款方式，根据需要科学规划融资方案，优化资本结构，合理控制融资成本和财务风险，确保足够的资金投入以满足项目建设需求。

5、因政府审批不通过，导致项目顺延、变更、中止或终止的风险

本次扩产投资项目尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，能否通过相关政府审批存在不确定性。项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将与地方政府、相关部门密切沟通，推动项目实施有关的审批工作。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日